



## 平成30年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年10月31日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役 専務執行役員 (氏名) 堀 哲朗

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成29年11月13日

配当支払開始予定日

平成29年11月27日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第2四半期	516,976	46.6	123,318	105.5	123,066	97.3	90,668	116.1
29年3月期第2四半期	352,722	3.5	60,012	2.0	62,365	0.0	41,966	1.4

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 96,850百万円 (196.1%) 29年3月期第2四半期 32,710百万円 (7.0%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第2四半期	552.59	550.74
29年3月期第2四半期	255.83	255.16

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30年3月期第2四半期	1,031,125	707,954	68.2
29年3月期	957,447	645,999	67.2

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 703,182百万円 29年3月期 643,094百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期		128.00		224.00	352.00
30年3月期		277.00			
30年3月期(予想)				328.00	605.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

### 3. 平成30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,130,000	41.3	271,000	74.1	271,000	72.0	198,000	71.9	1,206.73

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

## 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有  
新規 社 (社名) 、 除外 1 社 (社名) 東京エレクトロン東北株式会社  
詳細は、[添付資料]10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)」をご覧ください。
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有  
詳細は、[添付資料]10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 無  
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期2Q	165,210,911 株	29年3月期	165,210,911 株
期末自己株式数	30年3月期2Q	1,129,107 株	29年3月期	1,135,104 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期2Q	164,078,737 株	29年3月期2Q	164,043,016 株

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成29年10月31日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(セグメント情報等)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間につきましては、着実な景気回復の続く米国経済に加え、中国などアジア地域の景気拡大も継続しており、世界経済全体は緩やかな回復傾向が続いています。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、データセンター向けサーバの需要によりメモリの需要が大きく伸長したほか、ロジック系半導体などの出荷額も増えており、半導体・電子部品の市況は好調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高5,169億7千6百万円(前年同期比46.6%増)、営業利益1,233億1千8百万円(前年同期比105.5%増)、経常利益1,230億6千6百万円(前年同期比97.3%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は906億6千8百万円(前年同期比116.1%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

#### ① 半導体製造装置

伸長するサーバ需要にともない、需給の逼迫しているNANDフラッシュメモリやDRAMなどのメモリ向け設備投資が引き続き活発に行われました。また、ロジック系半導体についてもサーバ向けの先端開発投資が行われており、半導体製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、4,877億4千3百万円(前年同期比49.2%増)となりました。

#### ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

中国において、テレビ用大型液晶パネル向けの設備投資や、モバイル機器用の中小型有機EL・液晶パネル向けの設備投資が継続しており、FPD製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、290億2千4百万円(前年同期比13.9%増)となりました。

#### ③ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2億8百万円(前年同期比11.1%減)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
売上高	352,722	446,997	516,976	280,580
半導体製造装置	327,008	422,885	487,743	265,773
日本	44,248	46,954	65,244	38,468
北米	51,439	50,119	56,174	32,077
欧州	11,930	47,998	52,314	26,931
韓国	48,837	88,951	170,165	101,790
台湾	88,794	137,116	82,543	36,646
中国	54,093	36,575	49,830	23,073
東南アジア他	27,664	15,167	11,469	6,786
F P D製造装置	25,479	23,908	29,024	14,701
その他	234	203	208	104
営業利益	60,012	95,684	123,318	68,527
経常利益	62,365	95,184	123,066	67,917
親会社株主に帰属する 四半期純利益	41,966	73,242	90,668	49,415

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ572億6千5百万円増加し、8,332億4百万円となりました。主な内容は、たな卸資産の増加471億6千万円、現金及び預金の増加260億6千3百万円、未収消費税等の減少164億6千1百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少115億円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から109億8千5百万円増加し、1,114億2千6百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から10億1千万円増加し、164億1千2百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から44億1千6百万円増加し、700億8千2百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から736億7千8百万円増加し、1兆311億2千5百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ99億9千5百万円増加し、2,577億6千5百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の増加43億2千万円、賞与引当金の増加32億5千7百万円、未払法人税等の増加30億4千3百万円、前受金の減少38億6千1百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ17億2千8百万円増加し、654億5百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ619億5千4百万円増加し、7,079億5千4百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益906億6千8百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当367億5千2百万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は68.2%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ645億6千3百万円増加し、2,289億3千万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,010億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ145億6千3百万円増加し、3,299億3千万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ159億4千万円増加の679億4千7百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,223億1千1百万円、未収消費税等の減少164億7千4百万円、減価償却費90億2千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加448億2千4百万円、法人税等の支払額302億3千8百万円、売上債権の増加82億9百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の減少による収入500億円、有形固定資産の取得による支出166億7千7百万円により、前年同期の150億6千8百万円の支出に対し312億7千2百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払367億5千2百万円により、前年同期の183億7千7百万円の支出に対し368億2百万円の支出となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の連結業績につきましては、半導体製造装置及びFPD製造装置の市況は好調に推移することが見込まれるため、平成29年4月28日に公表した通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。なお、確定給付企業年金制度の一部を確定拠出年金制度に移行する方針を決定したことに伴い、概算で30億円の特別損失の発生を見込んでおります。

## 平成30年3月期の連結業績予想

	通 期
売上高	1兆1,300億円 (前期比 41.3%増)
半導体製造装置	1兆547億円 (前期比 40.6%増)
F P D製造装置	750億円 (前期比 51.9%増)
その他	2億円
営業利益	2,710億円 (前期比 74.1%増)
経常利益	2,710億円 (前期比 72.0%増)
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,980億円 (前期比 71.9%増)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	70,866	96,930
受取手形及び売掛金	133,858	142,850
有価証券	244,500	233,000
商品及び製品	152,629	185,256
仕掛品	51,112	61,441
原材料及び貯蔵品	32,514	36,719
その他	90,520	77,076
貸倒引当金	△63	△70
流動資産合計	775,938	833,204
固定資産		
有形固定資産	100,441	111,426
無形固定資産		
その他	15,401	16,412
無形固定資産合計	15,401	16,412
投資その他の資産		
その他	67,482	71,536
貸倒引当金	△1,816	△1,453
投資その他の資産合計	65,666	70,082
固定資産合計	181,508	197,921
資産合計	957,447	1,031,125

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	79,217	83,537
未払法人税等	31,069	34,112
賞与引当金	21,853	25,110
その他の引当金	10,470	12,385
その他	105,159	102,618
流動負債合計	247,770	257,765
固定負債		
その他の引当金	374	374
退職給付に係る負債	55,825	56,607
その他	7,476	8,422
固定負債合計	63,677	65,405
負債合計	311,447	323,171
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	503,325	557,220
自己株式	△7,766	△7,727
株主資本合計	628,543	682,477
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,788	14,338
繰延ヘッジ損益	59	△170
為替換算調整勘定	5,789	9,023
退職給付に係る調整累計額	△2,086	△2,486
その他の包括利益累計額合計	14,551	20,705
新株予約権	2,620	4,503
非支配株主持分	284	268
純資産合計	645,999	707,954
負債純資産合計	957,447	1,031,125



## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
売上高	352,722	516,976
売上原価	214,032	301,561
売上総利益	138,689	215,415
販売費及び一般管理費		
研究開発費	39,805	46,062
その他	38,871	46,034
販売費及び一般管理費合計	78,677	92,097
営業利益	60,012	123,318
営業外収益		
保険配当金	300	334
為替差益	946	—
その他	1,236	1,328
営業外収益合計	2,483	1,663
営業外費用		
為替差損	—	1,769
その他	131	145
営業外費用合計	131	1,915
経常利益	62,365	123,066
特別利益		
固定資産売却益	43	73
その他	6	—
特別利益合計	50	73
特別損失		
固定資産除売却損	91	292
災害による損失	7,828	—
投資有価証券評価損	0	536
その他	74	—
特別損失合計	7,994	829
税金等調整前四半期純利益	54,420	122,311
法人税等	12,426	31,615
四半期純利益	41,993	90,695
非支配株主に帰属する四半期純利益	27	27
親会社株主に帰属する四半期純利益	41,966	90,668

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
四半期純利益	41,993	90,695
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,012	3,550
繰延ヘッジ損益	△25	△181
為替換算調整勘定	△7,375	3,229
退職給付に係る調整額	209	△404
持分法適用会社に対する持分相当額	△79	△38
その他の包括利益合計	△9,283	6,155
四半期包括利益	32,710	96,850
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	32,701	96,822
非支配株主に係る四半期包括利益	8	28

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	54,420	122,311
減価償却費	8,199	9,025
のれん償却額	307	325
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,900	3,161
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△745	1,554
売上債権の増減額 (△は増加)	△37,023	△8,209
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△15,353	△44,824
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,634	2,645
未収消費税等の増減額 (△は増加)	11,475	16,474
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△134	△1,230
前受金の増減額 (△は減少)	29,410	△4,742
その他	8,986	980
小計	72,077	97,470
利息及び配当金の受取額	659	715
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△20,729	△30,238
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,007	67,947
投資活動によるキャッシュ・フロー		
短期投資の増減額 (△は増加)	△5,201	50,000
有形固定資産の取得による支出	△9,631	△16,677
無形固定資産の取得による支出	△320	△2,163
その他	85	113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,068	31,272
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△4	△3
配当金の支払額	△18,371	△36,752
その他	△1	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,377	△36,802
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,775	2,145
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	13,786	64,563
現金及び現金同等物の期首残高	95,638	164,366
現金及び現金同等物の四半期末残高	109,425	228,930

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

東京エレクトロン山梨(株)と東京エレクトロン東北(株)は、平成29年7月1日付で東京エレクトロン山梨(株)を存続会社、東京エレクトロン東北(株)を消滅会社とする吸収合併を行い、東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株)に商号を変更しております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## ① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	487,743	29,024	8,896	525,664	△8,687	516,976
セグメント利益 又は損失(△)	144,829	2,724	△98	147,455	△25,144	122,311

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△25,144百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△10,765百万円等であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

## ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。